

株式の状況 (平成19年9月30日現在)

株式数および株主数

発行可能株式総数	78,000株
発行済株式総数	19,500株
株主数	839名

大株主

	持株数	持株比率
株式会社アルゴグラフィックス	9,900株	50.8%
セイコーインスツル株式会社	4,080株	20.9%
ジーダット従業員持株会	784株	4.0%
HSBC ファンド サービスズ クライアント アカウント 006	713株	3.7%
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	231株	1.2%
石橋 真一	150株	0.8%
日本証券金融株式会社	107株	0.5%
株式会社エスケーエレクトロニクス	90株	0.5%
株式会社図研	90株	0.5%
大日本印刷株式会社	90株	0.5%
凸版印刷株式会社	90株	0.5%

所有者別状況

所有者区分	株式数	持株比率
金融機関	402株	2.1%
証券会社	201株	1.0%
その他国内法人	14,373株	73.7%
外国法人等	758株	3.9%
個人その他	3,766株	19.3%
計	19,500株	100.0%



株式会社ジーダット

本社 東京都中央区日本橋小舟町6-6
Tel 03-5847-0312 (代)
URL <http://www.jedat.co.jp>

当冊子に関するお問合せ先
株式会社ジーダット 経営企画部
E-mail: corporate.planning1@jedat.co.jp

株主メモ

上場市場	JASDAQ
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	3月31日
株式の売買単位	1株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
同取次所	みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 (http://www.jedat.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。



株式会社ジーダット

第 6 期

中間事業報告書

平成19年4月1日～平成19年9月30日





社名の JEDAT は
Japan EDA Technologies の略です。
私たちは、日本のEDAのリーダーとして、
電子産業の発展に貢献したいと考えています。

EDA とは
Electronic Design Automation の略です。

電子機器や電子部品の設計作業を支援、検証するソフトウェア(電子系CAD)で、
設計作業には不可欠なツールであり、設計期間の短縮や設計品質の向上を実現します。

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また当社の事業活動につきまして、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第6期中間事業報告書をお届けするにあたり、まず始めに、前年上半期に比べて減収減益となりましたことをご報告申し上げます。残念ながら皆様のご期待にお応えできませんでしたことを大変申し訳なく思っております。

減収の大きな要因の一つは、当社の予想以上に、国内液晶パネルメーカーの設備投資が抑制あるいは先送りされたこととあります。二つ目は、この落ち込みをカバーすべき海外販売強化のタイミングが出遅れたこととあります。この減収が、当社のような固定費主体の費用構造の企業には、利益に直接反映され、大幅減益となりました。他方、減収の中でも、サービス売上は伸びており、これは事業の安定度のプラスを示していると考えております。

製品開発では数年先を見据えた新技術・新製品の開発

を開始しております。また、顧客である電子設計技術者に対する複合的なソリューションとして、IP (Intellectual Property: 知的資産としての回路図) をご提供するために、株式会社Aソリューションを7月に設立しました。また10月には「JEDAT EDA Fair」を開催し、ユーザ事例など実務的な効果の高い発表を行い、昨年を大きく上回るお客様に会場していただきました。

当下半年は、引き続き米国景気など不安要因がありますが、市場の動向に十分に注視し、確実に計画を達成して参る所存でございます。株主の皆様には、今後ともご理解とご支援の程、どうかよろしく願い申し上げます。



代表取締役社長
石橋 眞一

営業の概況

当社企業グループの主要顧客である半導体、FPD等の製造業は、国際的な厳しい価格競争の中で企業間格差が拡大し、上位企業以外は採算が厳しい傾向となっています。特に液晶等の製造業におきましては、表示パネルの数量は順調に伸びているものの、価格下落の進行により、利益の出ない構造となっており、この中間期以降も全体として設備投資抑制の傾向が続くものと予想されております。

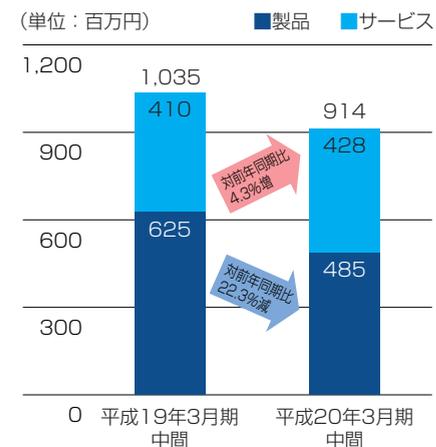
その中で当社企業グループは、主力製品である「α-SX」の機能強化を推し進め、顧客の大幅な生産性向上のための提案を重ねてまいりましたが、設備投資抑制の壁を越えるまでには至らず、前中間期に対して減収減益となりました。

売上高は、9億14百万円(前年同期比11.8%減)、営業利益は25百万円(前年同期比85.1%減)、経常利益は71百万円(前年同期比67.6%減)、中間純利益は46百万円(前年同期比67.5%減)であります。売上高の

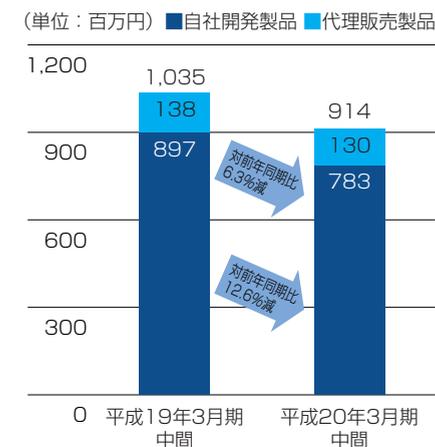
うち、サービス売上高が4億28百万円(前年同期比4.3%増)と順調に伸びたのに対し、製品売上高は4億85百万円(前年同期比22.3%減)と苦戦いたしました。また、市場分野別では、半導体市場の売上高が5億76百万円(前年同期比5.6%増)と伸びたのに対し、FPD市場では、顧客の設備投資削減や先送りのため、売上高は3億37百万円(前年同期比31.1%減)となりました。

当年度上半期の主な活動内容としては、継続的な自社開発製品の強化のほか、国内FPD分野での投資抑制をカバーすべく、海外販売を強化いたしました。また、半導体分野での事業強化を狙いとして、株式会社Aソリューションを設立し、IP分野への事業拡大を図るとともに、EDA事業への貢献を企図しております。また、DFM分野では、主力製品HOTSCOPEの海外販売を強化するとともに、米国Takumi Technology Corp.との出資を含めた業務提携契約を締結し、代理販売を開始いたしました。

製品/サービス売上高



自社開発製品/代理販売製品売上高



半導体市場/FPD市場売上高



中間連結財務諸表 (平成19年4月1日～平成19年9月30日)

中間連結貸借対照表

				(単位:千円)			
科目	前中間期末 (平成18年9月30日)	当中間期末 (平成19年9月30日)	前期末 (平成19年3月31日)	科目	前中間期末 (平成18年9月30日)	当中間期末 (平成19年9月30日)	前期末 (平成19年3月31日)
資産の部				負債の部			
流動資産	① 2,011,917	1,663,170	2,488,051	流動負債	534,646	455,629	502,825
現金及び預金	1,388,254	1,138,737	1,917,379	買掛金	86,704	69,814	138,798
受取手形及び売掛金	413,691	389,277	481,186	未払法人税等	97,920	31,161	101,965
たな卸資産	18,348	15,350	17,104	賞与引当金	85,064	78,066	82,359
その他	191,623	119,805	72,382	前受金	177,230	207,173	84,871
固定資産	① 308,209	1,100,435	310,576	その他	87,727	69,413	94,830
有形固定資産	16,346	21,721	21,364	負債合計	534,646	455,629	502,825
無形固定資産	110,034	43,452	78,477	純資産の部			
のれん	107,700	35,900	71,800	株主資本	② 1,783,905	2,310,884	2,293,304
ソフトウェア	2,334	7,552	6,677	資本金	527,739	760,007	760,007
投資その他の資産	181,828	1,035,261	210,733	資本剰余金	658,290	890,558	890,558
繰延税金資産	123,101	157,026	146,310	利益剰余金	597,875	660,319	642,738
長期性預金	—	700,000	—	評価・換算差額等	1,574	△2,907	2,497
その他	58,727	178,235	64,423	その他有価証券評価差額金	—	△6,510	—
資産合計	2,320,126	2,763,606	2,798,627	為替換算調整勘定	1,574	3,602	2,497
				純資産合計	1,785,480	2,307,977	2,295,802
				負債純資産合計	2,320,126	2,763,606	2,798,627

① 流動資産、固定資産

流動資産の減少ならびに固定資産の増加は、主に投資有価証券の取得、ならびに長期性預金への預入によるものであります。

② 株主資本

株主資本の増加は、主に資本金及び資本剰余金が平成19年3月の株式上場により増加したこと、ならびに利益剰余金によって増加したことによるものであります。

中間連結損益計算書

				(単位:千円)			
科目	前中間連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	科目	前中間連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)	当中間連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
売上高	1,035,877	914,111	2,095,540	営業活動によるキャッシュ・フロー	226,152	76,545	319,032
売上原価	276,565	294,521	622,047	投資活動によるキャッシュ・フロー	④ △2,345	△827,041	△24,977
売上総利益	759,312	619,590	1,473,492	財務活動によるキャッシュ・フロー	546,733	△29,250	1,004,686
販売費及び一般管理費	588,166	594,072	1,266,267	現金及び現金同等物に係る換算差額	△124	1,104	799
営業利益	171,145	25,517	207,225	現金及び現金同等物の増減額(減少△)	770,415	△778,641	1,299,540
営業外収益	③ 51,230	48,889	95,680	現金及び現金同等物の期首残高	617,838	1,917,379	617,838
営業外費用	2,066	3,051	11,914	現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	1,388,254	1,138,737	1,917,379
経常利益	220,309	71,355	290,991				
税金等調整前中間(当期)純利益	220,309	71,355	290,991				
法人税、住民税及び事業税	96,647	28,085	145,276				
法人税等調整額	△20,490	△3,560	△43,302				
中間(当期)純利益	144,153	46,830	189,016				

中間連結株主資本等変動計算書

	株主資本				評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成19年3月31日残高	760,007	890,558	642,738	2,293,304	—	2,497	2,497	2,295,802
中間連結会計期間中の変動額								
剰余金の配当			△29,250	△29,250				△29,250
中間純利益			46,830	46,830				46,830
株主資本以外の項目の中間 連結会計期間中の変動額(純額)					△6,510	1,104	△5,405	△5,405
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	17,580	17,580	△6,510	1,104	△5,405	12,175
平成19年9月30日残高	760,007	890,558	660,319	2,310,884	△6,510	3,602	△2,907	2,307,977

③ 営業外収益

営業外収益は、主に開発助成金を計上したことによるものであります。

④ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローとしては、投資有価証券の取得ならびに長期性預金への預入により、8億27百万円の支出となりました。

Takumi社と業務提携を行いました

2007年5月、当社は米国Takumi社との業務提携を行いました。この提携により、当社はTakumi社製品の国内代理店となり、DFM (Design For Manufacturability: 半導体製造の事を考慮した設計手法/設計ツール) 分野の製品ラインアップを強化いたしました。同時に当社は、Takumi社との関係を強化するために、Takumi社へ100万ドルの出資

を行いました。今後、両社の製品・技術面での連携を進めます。

Takumi社は米国とオランダに研究・開発拠点をもち米国の企業ですが、株主には、当社のほか、日本の大手半導体メーカー数社が入っており、日本市場を重要視しています。

連結子会社「株式会社A-ソリューション」を設立

A-ソリューションがChipidea社と業務提携を行いました

2007年7月、当社は、大手半導体メーカーからトップレベルの技術者をCTOとして迎え、100%子会社「株式会社A-ソリューション (略称: ASI)」を設立いたしました。また、ASIは8月にポルトガルのChipidea社と業務提携を行いました。Chipidea社は、アナログ回路IP (Intellectual Property: 知的資産としての回路図) ベンダで、CMOSアナログ回路の分野では世界一位のシェア*をもっています。

ASIは、高度な技術力によって、日本のアナログ回路設計技術者に対して、Chipidea社の高性能なアナログ回路IPの技術コンサルティング及び販売を行います。アナログ回路設計技術者は当社のEDA事業の顧客でもあり、ASIと合わせて、複合的なソリューションを提供できるようになります。さらには、ASIから最先端の設計ニーズをEDA製品にタ

イムリーに反映させることもでき、グループ全体として大きなシナジー効果が得られると考えています。

*2005年実績、Gartner Inc.による



A-ソリューション設立記念パーティーでスピーチをする
ジョアン・ペドロ・ザナッティ駐日ポルトガル大使



JEDAT EDA Fair 2007を開催しました

2007年10月17日 (大阪会場)、19日 (東京会場) の2日間、当社のプライベートショウ『JEDAT EDA Fair 2007』を開催いたしました。今年は、“設計TAT短縮: 1/3”をテーマに、当社主力製品である α -SXによる設計効率の大幅な改善のご提案、および当社が代理販売



デモンストレーション会場の様子

しているアナログ設計向け最先端製品やDFM製品、(株)A-ソリューションのご紹介を行いました。ショウは特別講演、2つのユーザー事例発表を含む計12セッションのセミナーと、計11ゾーンのデモコーナーで実施いたしました。大阪、東京両会場とも昨年を上回る (16%増) お客様にご来場頂き、大盛況の2日間でした。



セミナー会場の様子

会社概要 (平成19年9月30日現在)

商号	株式会社ジードット (Jedat Inc.)
所在地	〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6-6
代表者	代表取締役社長 石橋 眞一
営業開始	2004年2月2日
資本金	760,007,110円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売およびコンサルティング
関連会社	株式会社ジードット・イノベーション (Jedat Innovation Inc.) 福岡県北九州市若松区ひびきの2-5 情報技術高度化センター 績達特軟件 (北京) 有限公司 (Jedat China Software Inc.) 北京市西城区新街口外大街28号B座409-412室 URL http://www.jedat-soft.com.cn 株式会社A-ソリューション (A-Solution Inc.) 東京都中央区日本橋小舟町6-6 URL http://www.a-solutioninc.com
所属団体	社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) 社団法人 日本半導体ベンチャー協会 (JASVA) 有限責任中間法人 日本エレクトロニクスショー協会 (JESA) 日本EDAベンチャー連絡会 (JEVeC)

役員 (平成19年9月30日現在)

代表取締役社長	石橋 眞一
取締役	増山 雅美 (経営企画部長)
取締役	藤岡 督也 (EDA営業技術部長)
取締役	香月 弘幸 (システム部長)
取締役	藤澤 義磨 (株)アルゴグラフィックス 代表取締役会長 兼 CEO
取締役	斎藤 成一郎 (株)アルゴグラフィックス 取締役 常務執行役員
取締役	新保 雅文 (セイコーインスツル (株) 代表取締役社長)
監査役	飯村 雄次 (常勤)
監査役	吉田 隆男 (財)新世代研究所 専務理事)
監査役	伊藤 俊彦 (株)アルゴグラフィックス 執行役員)